

DT-GLD箔 (両面処理箔)

概要

デジタル機器の小型軽量化・高機能化に応えますビルドアップ工法用に開発された「DT-GLD箔」は国内最大手メーカーの携帯電話基板に採用され、携帯電話の飛躍的な小型軽量化・高機能化の一翼を担っています。

特長

品質特性に定評のあるGTS処理を行った両面処理箔です。12～35 μ mまでの箔厚をラインナップしています。ビルドアップ基板に最適な両面粗化処理箔です。

代表的な用途

ビルドアップ配線板

高密度多層配線板

仕様

項目		板厚 [μ m]		
		12	18	35
質量厚さ [g/m^2]		135	170	305
引張強さ [N/mm^2]	常温	340	330	300
	180	170	170	170
伸び [%]	常温	6	7	21
	180	3	3	11
表面粗さ (Rz) [μ m]	粗化処理面	8	9	9
	光沢面	5.5	5.5	5.5
ピール強度 [kN/mm^2] (v.s. FR-4)	粗化処理面	1.39	1.57	2.04
	光沢面	1.13	1.27	1.58
耐湿劣化率 [%] (v.s. FR-4)	粗化処理面	2.4	3.2	3.5
	光沢面	1.4	1.6	1.6